



TIA™600P系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上，这些胶带具有极强的粘合强度，并且热阻抗小，可以有效的取代滑脂和机械固定。

特性

- 》导热率 **0.8 W/mK**
- 》高性能热传导压克力胶
- 》高粘结强度各种表面的双面压敏胶带
- 》等同于UL94V0

应用

- 》使散热片固定于已封装之芯片上
- 》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
- 》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式

TIA™600P 系列特性表

产品型号	TIA605P	TIA608P	TIA610P	测试方法
颜色	白色			目视
胶粘剂类型	压克力胶粘剂			*****
基材类型	聚对苯二甲酸乙二酯薄膜(PET)			*****
使用温度范围	-45 °C to 120 °C			*****
厚度	0.005" 0.127mm	0.008" 0.203mm	0.010" 0.254mm	ASTM D374
击穿电压	> 1000 Vac	> 1200 Vac	> 1500 Vac	ASTM D149
导热率	0.8 W/mK			ASTM D5470
180°剥离强度	> 1200 g/inch (即时贴合不锈钢板)			PSTC-1
180°剥离强度	> 1400 g/inch (贴合预置处理24小时)			PSTC-1
保持力 25 °C/Hours	> 48 Hours			PSTC-7
保持力 80 °C/Hours	> 48 Hours			PSTC-7
防火等级	等同于94V0			*****

标准厚度:

0.005"(0.127mm) 0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm)

如需不同厚度请与本公司联系。

标准尺寸:

40" x 100'(1016mm x 30.48M)TIA600P系列可模切成不同形状提供。

补强材料:

TIA™600P系列卷材可带PET为补强

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网：<http://www.ziitek.com>

Thermal Conductive Interface Materials
Application Technology Download



<http://www.ziitek.com>

导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大Canada
TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://z/www.thermazing.com>

台湾Taiwan
TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com.tw>

东莞Dongguan
TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com.cn>

昆山Kunshan
TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com
<http://www.ziitek.com.cn>

杭州Hangzhou
TEL: +86-571-63850366
E-mail: alex@ziitek.com
<http://www.ziitek.com.cn>

长沙Changsha
TEL: +86-731-86949836
E-mail: jor@ziitek.com
<http://www.ziitek.com.cn>